

「シリコン材料・デバイス研究会(SDM)」にて講演

株式会社ソシオネクストは、2016年1月22日(金)に開催される「シリコン材料・デバイス研究会(SDM)」にて招待講演を行います。

「シリコン材料・デバイス研究会(SDM)」は電子情報通信学会のエレクトロニクスソサイエティ部門が主催する研究会です。当社は、株式会社富士通研究所と共同で「常温12年応力変動の結果から、銅配線の Stress Migration メカニズムの再考」をテーマに、ストレスマイグレーションのメカニズムに関する議論および考察内容について発表します。

【名 称】 シリコン材料・デバイス研究会(SDM)

<http://www.ieice.org/jpn/kaikoku/pdf/2801/link/es/kenc-sdm22.pdf#zoom=75%>

【会 期】 2016年1月22日(金)

【会 場】 東京大学山上会館

東京都文京区本郷 7-3-1

<http://www.sanjo.nc.u-tokyo.ac.jp/>

【主 催】 電子情報通信学会 エレクトロニクスソサイエティ

【発 表】

「常温12年応力変動の結果から、銅配線の Stress Migration メカニズムの再考」
ソシオネクスト 品質保証統括部信頼性保証部 松山 英也

以 上